

KLA, 새로운 첨단 반도체 패키징 시대를 위한 광범위한 IC 기판 포트폴리오 발표

- *패널 기반 상호 연결 혁신으로 칩 성능을 높이는 새로운 포트폴리오*
- *KLA 는 시장에서 검증된 Corus™ 직접 이미징 플랫폼의 역량을 확대하며, Serena™ 직접 이미징 플랫폼을 도입하여 메인스트림 및 첨단 IC 기판 리소그래피 요구 사항을 지원*
- *새로운 Lumina™ 검사 및 계측 시스템으로 IC 기판 (글라스코어 포함) 및 패널 기반 인터포저 제조업체가 우수한 품질과 수율로 첨단 제품을 효율적으로 제조*

캘리포니아 밀피타스, 2024 년 10 월 15 일 – 오늘 **KLA Corporation**(나스닥: KLAC)은 IC 기판 (ICS) 제조를 위한 업계에서 가장 광범위한 공정 제어 및 공정 구현 솔루션을 소개했다. KLA 의 프론트엔드 반도체, 패키징 및 IC 기판 관련 전문 지식을 결합하여 고객은 고성능 애플리케이션을 대상으로 하는 칩의 패키징 인터커넥트 밀도에서 획기적인 성과를 달성할 수 있다.

KLA Corporation 은 이제 IC 기판 제조를 위한 업계에서 가장 넓은 범위의 공정 제어 및 공정 지원 솔루션을 제공합니다. IC 기판 및 인터포저와 같은 패널 기반 중간 패키징 수준의 혁신이 가속화됨에 따라, 고객은 고성능 애플리케이션을 대상으로 하는 칩의 패키징 인터커넥트 밀도에서 획기적인 개선을 이루기 위해 새로운 솔루션을 필요로 합니다.

첨단 패키징은 지속적으로 이기종 집적 방법을 적용함으로써 여러 반도체 부품을 통합하여 성능, 전력 및 비용의 이점을 제공한다. 진화하는 상호 연결 요구 사항을 충족하기 위해 IC 기판 및 인터포저와 같은 패널 기반 패키징 기술의 혁신은 가속화하고 있다. 이러한 기술은 칩과 인쇄 회로 기판 (회로)을 효율적으로 연결하는 데 사용된다. 패키지 크기는 증가하고, 사양은 줄어들고, 글라스(glass)와 같은 새로운 소재가 도입됨에 따라 제조업체는 KLA의 솔루션 포트폴리오를 활용하여 수율을 높이고 납품 주기를 단축하며 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있다.

KLA의 DI(직접 이미징), 결함 검사, 형상화, 계측, 화학 공정 제어 및 지능형 소프트웨어 솔루션으로 구성된 포괄적인 포트폴리오 덕분에 첨단 패키징 제조 워크플로우가 최적화된다.

KLA의 포트폴리오에는 다양한 고객의 포토 리소그래피 요구 사항을 지원하는 다양한 직접 이미징 솔루션이 포함되어 있다. Corus™ 직접 이미징 플랫폼을 제조업체에서 도입하는 것은 매우 유연하고 효율적인 이미징 솔루션을 제공하는 데 있어 검증된 역량을 보여주는 것이다. IC 기판 및 차세대 고밀도 인터커넥트(HDI)와 같은 응용 분야에 대한 진화하는 요구를 충족하기 위해 차세대 광학 기술 및 레이저를 통해 다양한 패널 지형에서도 동적 이미징 및 레이어 간 정확도를 빠르게 최적화할 수 있다.

첨단 IC 기판 어플리케이션 분야의 경우, 직접 이미징은 리소그래피에서 스테퍼를 넘어 새로운 범주를 형성한다. KLA는 유연한 디지털 솔루션의 효율성으로 정확성과 수율을 높이기 위해 대용량의 고층 유기 기판을 더욱 정밀하게 가공하는 새로운 Serena™ 직접 이미징 플랫폼을 도입한다.

KLA의 첨단 IC 기판 (글라스코어 포함) 및 패널 기반 인터포저를 위한 새로운 검사 및 계측 시스템인 Lumina™는 최적화된 소유 비용으로 고감도 검출 및 스캐닝 계측을 가능하게 한다. 이 시스템은 운영자의 입력 없이도 실행 가능한 불량 파레토 차트에 대한 AI 기반 검사 및 분류와 모니터링을 제공하며, KLA의 불량 수정 솔루션과 원활하게 통합한다.

이 포트폴리오는 Orbotech Ultra PerFix™, EcoNet™, Zeta™-6xx, ICOS™ T890, Quali-Fill® Libra® 및 QualiLab® Elite 제품군을 특징으로 하는 입증된 KLA 공정 제어 솔루션으로 강화한다. KLA의 Frontline 소프트웨어 솔루션은 엔지니어링, 컴퓨터 지원 제조(CAM) 및 생산 데이터 분석을 포괄하여 IC 기판 제조 전반에 걸쳐 정보를 중앙 집중화하고 적용함으로써 KLA의 수율 관리 리더십을 보여준다.



KLA Corporation 의 부사장 겸 최고 전략 책임자인 Oreste Donzella 는 “오늘 발표한 포트폴리오 소식을 통해 KLA 는 반도체 생태계 혁신 분야에서 우리의 리더십을 확증하고 있습니다.”라고 말했다. “IC 기판 및 기타 패널 수준의 패키징 기술은 미래의 고성능 칩에서 연결성을 향상시키는 데 필수적이며, KLA 는 복잡한 생산 과제를 해결하여 고객의 수율과 사업 성공을 극대화하기 위해 협력하고 있습니다.”

KLA 의 포괄적인 IC 기판 솔루션 포트폴리오에 대한 자세한 내용은 다가오는 **TPCA 전시회**에서 확인할 수 있다.

KLA 소개

KLA Corporation(이하 "KLA")은 전자 산업 전반에 걸쳐 혁신을 가능하게 하는 업계 최고의 장비와 서비스를 개발합니다. 당사는 웨이퍼 및 레티클, 집적 회로, 패키징 및 인쇄 회로 기판 제조를 위한 고급 공정 제어 및 공정 구현 솔루션을 제공합니다. 전 세계 주요 고객과 긴밀히 협력하며 물리학자, 엔지니어, 데이터 과학자 및 문제 해결사로 구성된 전문가 팀은 세계를 발전시키는 해결책을 설계합니다. 투자자와 다른 사람들은 KLA 가 SEC 제출 문서, 보도 자료, 공개 어닝 콜 및 컨퍼런스 웹캐스트를 포함하는 중요한 재무 정보를 투자자 홍보 웹사이트(ir.kla.com)를 통해 발표한다는 사실에 주목해야 합니다. 추가 정보는 www.kla.com 에서 확인할 수 있습니다.

미래 예측 진술서

역사적 사실을 제외한 IC 기판 제품 포트폴리오의 기대 성능과 관련한 내용등과 같은 이 보도자료의 내용은 미래 지향적 진술이며 1995 년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 제정된 면책 조항의 적용을 받습니다. 이러한 미래 지향적 진술은 현재의 정보와 기대에 기반하고 있으며 위험과 불확실성과 관계되어 있습니다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 요인으로 인해 앞서 진술에서 예측된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 신기술의 채택의 지연(비용 또는 성능 문제 또는 기타 이유에 기인함), 다른 회사의 경쟁 제품 도입, 또는 KLA 의 제품의 구현, 성능, 사용에 영향을 미치는 예상치 못한 기술 문제 또는 한계, 2024 년 6 월 30 일이 마감인 해의 10-K 양식 KLA 의 연례 보고서와 KLA 가 증권 거래 위원회에 제출한 자료에 포함된 기타 위험 요소(여기에 설명된 위험 요소를 포함하되 이에 국한되지 않음). KLA 는 이러한 미래 지향적 진술을 업데이트할 의무가 없으며 현재 그러한 의도가 없습니다.

투자자 관계: 케빈 케셀, 투자자 관계 담당 부사장, kevin.kessel@kla.com

미디어 관계: 마이크 덜린, 기업 커뮤니케이션, michael.dulin@kla.com

+++++